

Fine**XT 5205**

多目的ダイボンディング装置

カスタマイズ適応した理想的な量産ソリューション

- >>> 5種類までの実装プロセスに対応したボンディングヘッドを選択できるスロットを装備
- >>> アクティブアライメントによるMID 3Dアッセンブリ対応



1つのレシピでの複数の実装プロセスに対応

幅広い対応コンポーネントサイズ

3Dカメラシステム

将来に渡る機能拡張を可能にするモジュー ルプラットフォーム

自動基板搬送システムによるイ ンライン対応 トレイ・テープ フィーダーを含む幅広いコンポーネント供給方法

ワーキングエリアは装置導入後も変更可能

広範囲ボンディングエリア

特長

利点 マルチチップ対応 多様なツールとイジェクターを用いて複雑なパッケージ製 品の組み立てに、単一プロセス時に複数種のチップハ ンドリング マルチウェハー対応 ダイイジェクトモジュールを使用した複数のウェハーからのチップ ピックアップ、およびカセットを介したウェハーのロードアンロード 単一システム内において様々な実装方法を選択可能、 各種の実装プロセスに対応 (接着剤はんだ熱圧着超音波) 多様なプロジェクトに対応するための自由度 3色LED照明 異なる素材に対する優れたコントラスト/ 優れた可視性と画像認識による パラメータに関連付いた全てのプロセスの同期制御 最大限のプロセス管理と再現性 TCP (MES, SMEMA) 経由でのプロセスおよび 単独デバイスの完全なトレーサビリティおよび、最高歩 素材のトレーサビリティ 留まりのためのプロセスおよび生産ライン管理

全自動部材管理

自動ツール管理

実装方式

- » 焼結法
- » 熱圧着ボンディング
- » 超音波/超音波熱圧着ボンディング
- » はんだ方式/共晶はんだ方式
- »接着剤ボンディング
- » レーザーアシストダイボンディング

対応プロセス

- » フリップチップボンディング(フェースダウン)
- » 高精度ダイボンディング(フェースアップ)
- » 3D-MID ボンデング
- » 3Dおよび2.5D ICパッケージング
- » マルチチップパッケージング (MCM,MCP)
- » チップオングラス (CoG)
- » チップオンフレックス/フィルム (CoF)
- » グラスオングラス
- » フレックスオンボード
- » チップオンボード (CoB)

アプリケーション

- » IGBTアッセンブリ
- » ハイパワーレーザーモジュールアッセンブリ

異なるコンポーネントサイズを伴う個別プロセスの為に、段

一括部材供給による連続的かつ高速ステータスログ

» 汎用MOEMSアセンブリ

取り替え不要のツール交換

取得も含むプロセスフロー

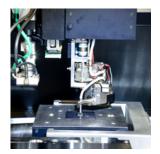
- » 汎用MEMSアセンブリ
- » NFCデバイスパッケージング
- » RFIDモジュールアセンブリ
- » イメージセンサーアセンブリ
- »加速度センサーアセンブリ
- » ガス圧力センサーアセンブリ
- »機構部品アセンブリ
- » 超音波トランシーバーアセンブリ
- » RF/HFモジュールアセンブリ

モジュール及びオプション

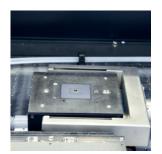
- » 自動デャパングユニット
- » 自動ツール交換モジュール
- » ボンディング荷重モジュール(自動)
- » カメラモジュール(3D)
- » カメラモジュール(テレセントノック)
- » カメラモジュール(下側カメラ)
- » チップ加熱モジュール
- » コンポーネント供給
- » ダイイジェクトモジュール
- » ダイフリップモジュール
- » デッピィング/スタンピングモジュール
- » デスペンサーモジュール
- » ギ酸ガスモジュール

- » ハンドリングモジュール
- » 高さ位置スキャナー(3Dカメラ)
- » 高さ測定センサ (レーザー)
- » 高さ測定センサ (メカニカル)
- » HEPAフィルター
- » IDコードリーダー
- » インデックス機能・コンベヤー
- » レーザー照射モジュール
- » レーザー加熱モジュール
- » リフトステーション
- » モータライズ ピッチ&ロール動作機能
- » プラズマ洗浄
- » 高精度スケール

- » プロセスガスモジュール
- » プロセスビデオモジュール
- » カセットノフト付きプログラマブルウ ェーハチェンジャー
- » スクラブモジュール
- » ハンダ除去モジュール
- » 基板加熱モジュール
- » 基板サポート
- » トレーサビリティモジュール
- » トレー・テープフィーダー
- » 超音波モジュール
- » UV硬化モジュール
- » ウエハ加熱モジュール



超音波モジュール



基板加熱モジュール



自動ツール交換モジュール



デッピィング/スタンピングモジュール







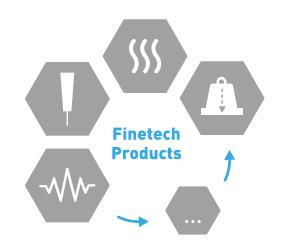






モジュール化の効果

FINEPLACER®には数多くのプロセスモジュールや機能モジュールが用意されているため非常に幅広い用途に対応することが可能ですこの柔軟性により初期段階ではその時点のニーズに適合した構成が選択可能ですことに私たちのシステムにはその耐用年数全体にわたって新しいタスクに追加対応することができますこれが我々の装置の重要なコンセプトの一つです。モジュールは容易に組み合わせたり交換したりできるためシステムの柔軟性が高まり、長期的に投資を無駄にせずに済みます。



5 μm

如何にして精度を測定するか

パッケージング技術のアセンブリシステムいわゆるダイボンダーではその搭載精度が装置性能の重要なキーポイントとなりますしかしその精度がどのような定義なのかまたそれをいつ、どのようにして測定するのかはしばしば明確ではありませんそのためファインテックでは、当社のダイボンディングシステムの精度がどのように定義され測定されているかについて、透明性がありかつ、検証可能な方法をご説明していますこのテクニカルペーパーでは、精度の背景や影響要因を説明しファインテック製品や他のメーカーの製品の精度仕様からお客様がどのような結論を導き出すことができるか

資料のダウンロードはこちら:

について情報を提供します。

カスタマーフィードバック

"We use a Finetech die bonder for complex flip chip, sensor and opto-electronics applications, along with co-development of new assembly processes for leading semiconductor customers. The bonder has allowed us to help customers develop, optimize, verify and enhance many state-of-the-art technologies."



Dhiraj BoraCEO & President, Silitronics

